기술분석 2019-163

2019. 12. 19

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서 YouTube요약 영상 보러가기



이녹스첨단소재(272290)

하드웨어/IT장비

IT소재의 미래를 열어가는 기업

요 약
기업현황
산업분석
기술분석
재무분석
주요 이슈 및 전망

작 성 기 관	한국기업데이터(주)	작 성 자	신재영 전문위원

■ 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.

■ 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것입니다. 또한 작성기관이 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다.
따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.

■ 해당 기업이 속한 산업에 대한 자세한 내용은 산업테마보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
* 산업테마보고서는 발간일정에 따라 순차적으로 발간 중이며, 현재 시점에서 해당기업이 속한 산업테마 보고서가 미발간 상태일 수 있습니다.

■ 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.

■ 본 보고서에 대한 자세한 문의는 한국기업데이터(주)(TEL.02-3215-2408, shin@kedkorea.com)로 연락하여 주시기 바랍니다.

한국IR협의회

전자정보용 고분자소재의 선도기업

이녹스첨단소재
(272290)

시세정보(12/17)	
현재가	52,000원
액면가	500원
시가총액	4,801억 원
발행주식수	9,232,420주
52주 최고가	60,900원
52주 최저가	31,600원
60일 평균 거래대금	52.63억 원
60일 평균 거래량	95,590주
외국인지분율	11.96%

투자지표 (억 원, IFRS연결)			
구분	2016	2017	2018
매출액	-	1,931	2,931
증감(%)	-	-	51.79
영업이익	-	221.7	383.0
이익률(%)	-	11.48	13.07
순이익	-	173.0	304.7
이익률(%)	-	8.96	10.39
ROE(%)	-	-	22.40
ROA(%)	-	-	11.62
부채비율(%)	-	77.92	105.33
유보율(%)	-	2,785	3,382
EPS(원)	-	3,226	3,302
BPS(원)	-	13,657	16,251
PER(배)	-	25.79	11.42
PBR(배)	-	6.09	2.32

- 벤처기업정신으로 이룩한 대한민국 대표 IT 기업
- 핵심소재의 국산화 선도와 첨단소재의 기술 확보
- OLED 시장 확대와 함께 비약적인 성장세

벤처기업정신으로 이룩한 대한민국 대표 IT 기업

이녹스첨단소재(이하 '동사')는 1988년부터 전자 정보용 소재의 국산화를 주도한 새한(옛 제일합섬)의 연구 인력을 중심으로 설립되었다. 2000년 새한이 워크아웃에 들어가자 반도체 패키징 소재를 개발했던 인력들은 새한을 나와 창업하였고, 동사의 모체가 되었다.

사업 첫해에 1백만원 정도에 불과하던 매출액은 2018년에 매출 2,931억원과 영업이익 383억원을 돌파하였고, 반도체 패키지, 연성회로기판(FPCB), OLED 소재 분야에서 세계 최대 생산능력을 보유하게 되면서 대한민국 대표 IT소재 전문기업으로 자리매김하고 있다.

[그림 1] 동사 아산 사업장



출처: 이녹스첨단소재

핵심소재의 국산화 선도와 첨단소재의 기술 확보

동사 기술연구소는 고객 Needs와 신소재 융합기술을 바탕으로 혁신적인 IT 소재를 지속적으로 시장에 선보이고 있다. 핵심기술로서 고분자 설계기술과 공정기술의 융합기술을 보유하고 있으며, 고분자 설계기술은 고분자 합성 기술, 고분자 배합 기술, Converting 기술을 바탕으로 폴리이미드, 에폭시, 폴리에스터, 이크릴 레진 등 기능성 수지들을 활용하는 기술이고, 공정기술은 중합 공정, 접착 테이프 제조공정, 고순도 정제 공정, 무결점 코팅 공정 등과 같은 공정기술을 접목하여 다양한 IT 분야의 점착 및 접착 테이프, 코팅 필름, 코팅용 Varnish 및 Paste

등 핵심 Solution 제품을 개발하는 기술이다.

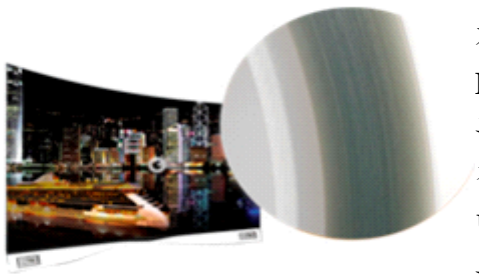
동사는 1999년 국내 최초로 FPCB용 LOC TAPE의 개발과 양산에 성공하면서 일본과 미국 등 선진국만이 독점하던 IT 소재를 국산화하기 시작하였고, FPCB 소재 사업은 대한민국을 넘어 세계 제일의 경쟁력을 보유한 Maker로 성장하였다. 그리고 반도체 패키지 소재인 경우 국내에서 유일하게 FULL-LINE UP을 갖춘 기업으로서 시장 위상을 견고히 하고 있다.

OLED 시장 확대와 함께 비약적인 성장세

OLED TV와 OLED 핸드폰의 시장 확대는 동사 매출 증가에 크게 기여하고 있다. 동사의 OLED용 소재 매출 비중은 2017년말 22.1%에서 2018년말 33.2%로 증가하였고, 2019 3Q는 더욱 증가하여 38.8%를 점유하며 동사 성장을 견인하고 있다

동사는 TV와 핸드폰에 사용되는 OLED의 주요 소재인 봉지재, 광감응성폴리이미드(PSPI), Back Plate Film 등을 제조하고 있으며, 삼성과 LG의 OLED 투자 확대를 통한 수요 증가를 기대하고 있다. LG디스플레이와 삼성디스플레이를 모두 고객사로 두고 있어 사업 확대 국면에도 유리한 고지를 차지하고 있고, 중국 광저우 공장을 설립하여 LG디스플레이와의 협력을 강화하며 해외시장 확대를 위한 기반을 마련하였다.

[그림 2] 동사의 OLED용 소재



*출처: 이녹스첨단소재

동사의 혁신적인 OLED 개발 활동의 결과로서 다양하고 가시적인 결과를 성취하였다. Flexible OLED 소재 국산화를 통해 삼성디스플레이의 혁신적인 원가 절감 효과를 인정받아 삼성으로부터 2018 혁신우수협력사 은상을 수상하였고, OLED용 봉지재 필름은 산업통상자원부 주관 2018년 세계일류상품에 선정되었다. 세계일류상품은 산업통상자원부가 주최하고 KOTRA가 인증하는 제품으로, 세계 시장점유율 5% 이상이고 5위 이내 지위를 가진 상품을 의미한다.

동사는 시장과 고객이 요구를 반영한 지속적인 연구개발을 바탕으로 신기술과 신가치 창조를 통해 Global No.1 Advanced Materials Company로 도약할 것으로 기대된다.

Ⅰ. 기업현황

FPCB용, 반도체 패키지용, OLED용 소재 전문 기업

동사는 2017년 6월 1일 주식회사 이녹스의 IT소재 사업부문이 인적분할하여 설립된 분할신설회사로서 2017년 7월 10일자로 한국거래소 코스닥 시장에 주식을 상장하였다. 본사는 충남 아산시에 위치하고 있으며, 고분자 합성과 배합기술을 기반으로 연성회로기판(FPCB) 소재, 반도체 패키지용 접착테이프, OLED 디스플레이 소재 등 IT 소재를 제조 판매하고 있다.

[표 1] 매출 유형(2018년 기준)

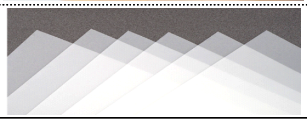
사업부문	품목	주요 상표	매출액(백만원)	매출비율
IT 소재	반도체 패키지용 소재	INNOSEM	38,986	13%
	FPCB용 소재	INNOFLEX SMARTFLEX	156,853	54%
	OLED 소재	INNOLED	97,276	33%
합계			293,115	100%

*출처: 이녹스첨단소재

2018년말 기준 매출액은 2,931억 원이며, 매출액의 54%는 FPCB용 소재, 33%는 OLED 소재, 13%는 반도체 패키지용 소재가 차지하고 있으나, 2019년 3분기에는 OLED 소재 매출이 증가하며 매출액의 38.8%를 차지하고 있다.

국내 FPCB 소재 시장인 경우 기존 Market Share를 유지할 수 있도록 개발 모델에 대한 적용 확대와 2 Layer FCCL 매출 극대화 등 전방위적 영업 활동을 전개하고 있으며, 신규 Item의 지속적인 발굴 참여를 통하여 매출을 확대하는 등, 적극적인 마케팅 노력 결과 국내 FPCB 소재 시장의 52%를 동사가 점유하고 있다.

[표 2] 동사 제품

구분	브랜드	형상
FPCB용 소재	INNOFLEX SMARTFLEX	
반도체 패키지용 소재	INNOSEM	
OLED용 소재	INNOLED	

*출처: 이녹스첨단소재

반도체 패키지용 소재인 경우 반도체 제조 패키지 공정에 사용되는 핵심소재로 기존에는 100% 수입에 의존하던 실정이었으나, 동사가 제품을 출시한 이후 지속적으로 수입품을 대체하고 있다. 반도체 패키지용 소재의 채용은 최종 고객의 지정에 의해 100% 좌우되는데, 동사 LOC Tape인 경우 전방업체인 Hynix의 사용승인을 획득함으로써 Hynix의 공급사인 Lead Frame 업체에 공급이 가능하게 되었으며, 국내에서는 유일하게 제품의 Full Line-Up을 갖추고 시장 요구에 대응하고 있다.

OLED Display는 풍부한 색재현성과 화질, 전력효율의 우수성 및 대량 생산에 따른 가격 하락으로 점차 사용 범위가 확대되고 있다. 동사는 주요 OLED 패널 제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하고 있다. 고객사가 원하는 사양의 소재를 개발하고 있으며, 지속적인 연구개발 활동을 통하여 고객사의 신제품 개발단계부터 동사 제품이 적용되는 등, 고객사와의 긴밀한 유대관계를 유지하고 있다.

동사 주요 고객인 LG디스플레이의 중국 광저우 공장이 본격 가동에 들어가는 시기에 맞추어 동사 또한 2018년 7월 사업확대 및 해외 생산거점 확보를 목적으로 중국 광저우에 GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.를 신규 설립하는 등 OLED 사업을 확대하고 있다.

동사는 적극적인 혁신 활동으로 Flexible OLED 소재 국산화를 통해 삼성디스플레이의 혁신적인 원가 절감 효과를 인정받아 '2018 혁신우수협력사 은상' 을 수상하였고, 지속적인 해외시장 개척의 결과로서 2010년 2천만불, 2011년 3천만불, 2013년 5천만불, 2014년 7천만불에 이어 2018년 1억불 수출의 탑을 수상하는 등 IT 소재 분야에서 높은 Brand Value와 시장지배력을 보유하고 있다.

[표 3] 시장 점유율(2018년 기준)

사업 부문	제품	업체	2018년	2017년
FPCB 소재	커버레이, FCCL, 보강판, 본딩시트, EMI Shield Film 등	㈜이녹스첨단소재	52%	45%
		국내 타사	43%	47%
		해외 업체	5%	5%
반도체 패키지 소재	DAF 등	㈜이녹스첨단소재	17%	17%
		국내 타사	12%	7%
		해외 업체	71%	76%
OLED 소재	봉지재 등	㈜이녹스첨단소재	50%	60%
		국내 타사	50%	40%

*출처: 이녹스첨단소재, 한국기업데이터 재구성

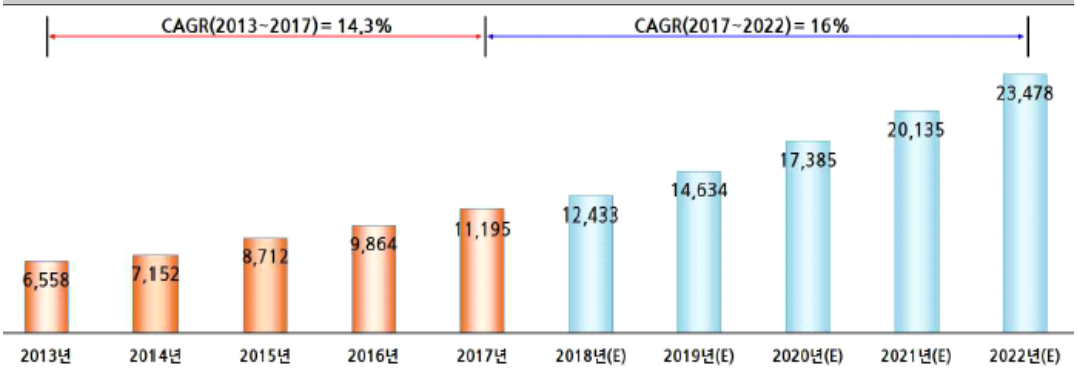
Ⅱ. 산업분석

FPCB 소재 사업 : 경박회로 제조용 필수 소재

연성회로기판(FPCB)은 기존 딱딱한 형상의 회로기판인 경성 PCB를 대체하는 매우 얇고 유연성 있게 휘어지는 기판으로써 최근 IT기기의 경박단소, 고기능화 추세에 맞추어 휴대전화, 노트북, 웨어러블 기기, 카메라 등의 회로기판으로 사용되고 있다.

FPCB 산업은 일반적인 PCB와는 달리 최신 소재, 설계, 공정 기술 등이 요구되는 첨단기술 산업이며, 주 수요처가 휴대폰, 디스플레이 등 전기·전자제품의 세트업체로 관련 산업 경기변동에 민감하며, 수출 비중이 높아, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등에 영향을 받는 산업이다.

[그림 3] 국내 FPCB 시장 규모(단위 : 억 원)



*출처: 한국신용정보원(TDB)

향후 플렉서블 디스플레이, 웨어러블 전자기기 등의 유연전자소자의 시장 확대가 예상되어 FPCB의 수요가 증가할 것으로 전망된다. 한국신용정보원 TDB 시장보고서(2019.05)에 의하면, 국내 FPCB 시장규모는 2013년 6,558억 원에서 2017년 1조 1,195 원으로 연평균 14.3% 증가하였으며, 이후 2022년까지 연평균 16.0% 성장하여, 2조 3,478억 원의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있다.

세계 FPCB의 시장규모는 2013년 120억 달러에서 2017년 148억 달러로 연평균 5.5% 증가하였으며, 이후 2022년까지 연평균 12.1% 성장하여, 262억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있다. 2017년 기준 분야별로 가전제품(54억 달러), 자동차(37억 달러), 군사 및 항공(21억 달러), 산업(20억 달러) 분야의 순으로 적용되고 있다.

전자제품의 소형화 및 경량화의 추세가 유지되고 있고, 자동차, 군사 및 항공 등의 분야에서도 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망되는 점과 FPCB의 굴곡성, 배선 밀도, 조립의 용이성, 경박성 등의 다양한 특성으로 인하여 향후 적용분야 및 범위가 확대될 것으로 예상되는 점이 시장 촉진 요인으로 작용하며, 기술적 진입장벽이 높고 대규모의 시설이 요구되는 산업으로, 신규 업체는 시

장에 진입하기 어려운 점과 다수 국내업체들의 경우 후처리를 수작업으로 진행하고 있어 비용 절감이 어려운 점이 시장 저해요인으로 작용하고 있다.

[표 4] FPCB 사업 리스크

항목	평가 <- 부정적 향후 긍정적 ->					비고
	1	2	3	4	5	
환경변화				○		- 스마트기기 증가로 시장이 크게 확대되었으며 향후 웨어러블 디바이스 트렌드 확산 시 사업 환경이 우호적일 것으로 판단됨
산업사이클				○		- 시장주기상 성숙단계에 있음
매출성장률				○		- 스마트기기 증가, 웨어러블 디바이스 보급 등 모바일 강세가 지속되는 한 매출 성장도 견조할 전망
진입장벽		○				- 제조 노하우 및 주요 구매처 공급 레퍼런스가 없는 기업은 시장 진입이 어려움
경쟁강도		○				- 업체들의 경쟁적 Capa 확대, 중국·대만 업체의 성장으로 경쟁강도가 심화되는 상황
대체재 위협				○		- FPCB는 기초 전자부품으로 대체재 위험이 크지 않음
기술중요도				○		- 기술력 없이는 시장 진입 자체가 어렵고, 고부가가치 제품을 수주하기 위해서는 기술력 확보가 필수적임
수익성				○		- 일반 PCB에 비해 카메라모듈용 FPCB 등 FPCB 제품은 부가가치가 높은 편임
안정성				○		- 안정된 국내외 수요처 확보

*출처: 한국신용정보원(TDB)

반도체소재사업 : 반도체패키징에서 사용되는 점착 및 접착 소재

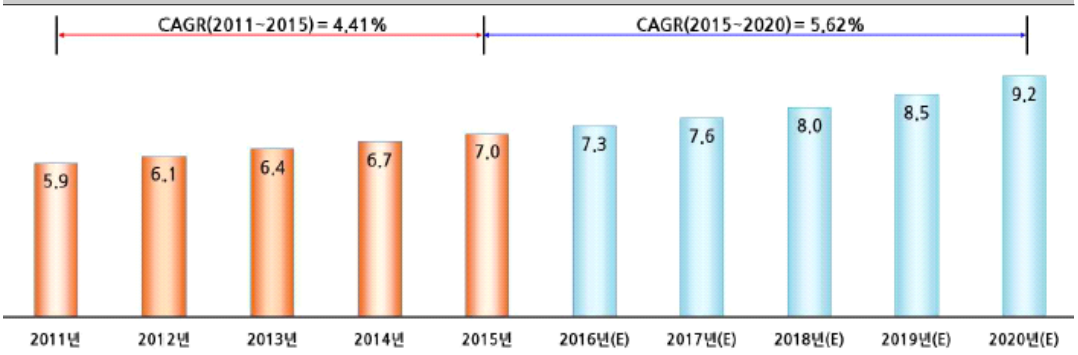
한국신용정보원 TDB 시장보고서(2017.04)에 의하면, 국내 반도체 패키지용 Die 접착제 시장은 2011년 584억 원에서 2015년 709억 원으로 증가하였고, 연평균 5.62%의 성장률을 보이면서, 2020년에는 932억 원에 달할 전망이다. 그리고 세계 반도체 패키지용 다이접착제 시장은 2011년 5.9억 달러에서 2015년 7억 달러로 증가하였고, 연평균 5.62%의 성장률을 보이면서, 2020년에는 9.2억 달러에 달할 전망이다.

전방 산업인 반도체 산업이 IT 기술의 발전과 동반 성장하고 있어, 반도체 패키지용 Die 접착제 시장도 꾸준히 성장할 것으로 전망되는 점이 시장 촉진 요인으로 작용하며, 전통적인 소재 기술의 강자들이 시장에서 독보적인 우위를

점하고 있는 점이 시장 저해요인으로 작용하고 있다.

반도체 패키지용 Die 접착제 산업은 메모리 반도체 분야에서 우위를 점하고 있는 국내 반도체 생태계에 힘입어 큰 성장 가능성을 보유하고 있으며, 동사는 국내외 패키징 업체와의 협력을 통해 시장점유율을 꾸준히 늘려가고 있다.

[그림 4] 세계 반도체 패키지용 Die 접착제 시장 규모(단위 : 억 달러)

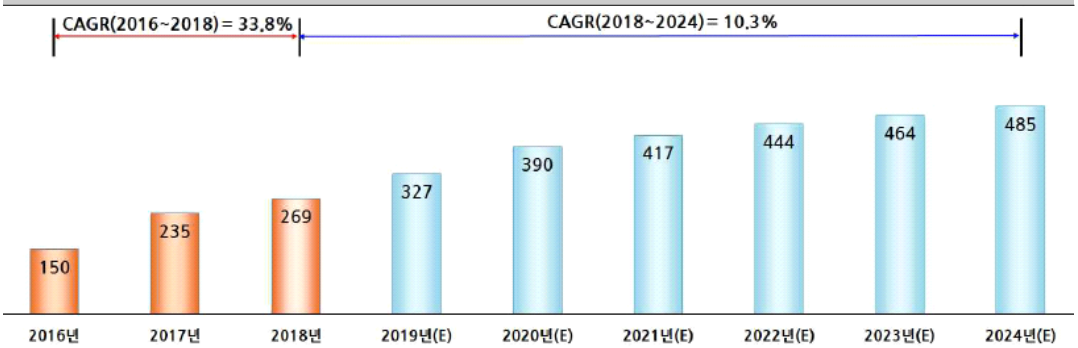


*출처: 한국신용정보원(TDB)

OLED 소재사업 : 디스플레이용 OLED 소재

OLED 디스플레이는 증착 공정의 난이도 문제로 기존의 LCD에 비해 고해상도 구현이 어려웠으나 많은 부분이 극복됨으로써 UHD급의 디스플레이 구현이 가능하며, 이를 이용한 초고화질 TV와 같은 프리미엄 디스플레이 시장의 성장이 전망되고 있다. 폴더블 스마트폰, 롤러블 TV 등의 플렉시블 디스플레이를 이용한 새로운 제품들이 출시되고 있어 OLED 디스플레이 수요처의 다변화가 예상되며, 곡면 성형이 가능한 특성을 활용한 차량용 디스플레이 시장이 새로운 수요처로 성장할 전망이다.

[그림 5] 세계 OLED 디스플레이 시장 규모(단위 : 억 달러)



*출처: 한국신용정보원(TDB)

국내 OLED 디스플레이 시장은 글로벌 디스플레이 선도 기업인 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 두 업체가 양분하고 있다. LG디스플레이는 세계 최초로 OLED TV 양산 시설을 구축한 기술 선도 업체로서 OLED와 컬러필터가 각각 발광과 발색을 담당하는 WOLED 디스플레이를 내세워 프리미엄 TV 시장을 공략하고 있으며, 최근 7세대와 8세대 LCD 제조 라인 구조조정을 통해 OLED 디스플레이 시장

에 집중하고 있다. 그리고 삼성디스플레이는 휴대폰용 OLED 디스플레이 시장을 주도하고 있으며 최근 폴더블 OLED 디스플레이 양산 기술을 확보하였다.

한국신용정보원 TDB 시장보고서(2019.09)에 의하면, 국내 OLED 디스플레이 시장은 2018년 10조 6,413억 원 규모이며, 이후 연평균 8.6%의 성장률을 보이면서 2024년에는 17조 4,571억 원의 시장규모를 형성할 것으로 전망되고 있다. 그리고 세계 OLED 디스플레이 시장은 2018년 269억 달러 규모이며, 이후 연평균 10.3%의 성장률을 보이면서 2024년에는 485억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망되고 있다. 2018년 기준 세계 OLED 디스플레이의 적용 분야별 시장 점유율은 스마트폰 83.5%, TV 8.1%, 웨어러블 디바이스 2.9%, 태블릿PC 2.5% 등의 순이다.

비평판형 플렉서블 디스플레이에 대한 수요와 관심도 증대로 OLED 디스플레이 시장의 성장이 예상되는 점과 세계 최고 수준의 OLED 디스플레이 기술과 대형 기술 선도 업체를 모두 보유하고 있어 시장 성장 촉진에 긍정적인 요인으로 작용하는 점이 시장 촉진 요인으로 작용되고, 강력한 정부 지원에 힘입은 중국 업체들의 디스플레이 생산 확장으로 공급 과잉에 의한 수익성 악화가 우려되는 점이 시장 저해 요인으로 작용하고 있다.

[표 5] OLED 분야 사업 리스크

항목	평가					비고
	<- 부정적		향후	긍정적 ->		
	1	2	3	4	5	
환경변화				○		- 디스플레이 산업은 국내 주력 산업으로, 다양한 R&D 지원정책이 수립되어 시행되고 있음.
산업사이클				○		- 시장주기상 성장기에 해당함.
매출성장률				○		- 당분간 LCD와 치열한 경쟁이 예상되나, 제품 경쟁력을 바탕으로 꾸준한 매출성장이 예상됨.
진입장벽	○					- 설계 및 제조에 높은 기술력이 요구되어 진입장벽은 상당히 높은 편임.
경쟁강도				○		- 양산 기업이 거의 없어 국내 기업의 독과점 체제임.
대체재위협		○				- LCD 등 다른 디스플레이 패널이 대체재로 작용할 수 있음.
기술중요도					○	- 유기물 증착, 밀봉, TFT 형성 등 상당히 높은 수준의 기술력이 요구됨.
수익성				○		- 디스플레이 패널이 적용되는 모바일 기기와 TV 모두 프리미엄급 제품군에 속해 수익성은 양호한 수준임.
안정성				○		- 안정적 수요처 확보로 안정성은 양호한 수준임.

*출처: TDB

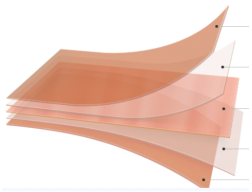
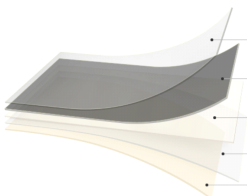
Ⅲ. 기술분석

Global No.1 첨단소재 개발을 선도

국내 FPCB를 제조하는 회사는 약 10여개사가 있으며, 동사는 FPCB에 사용되는 다양한 소재를 INNOFLEX 브랜드로 공급하고 있다.

FPCB는 경성 PCB와 달리, 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 인쇄회로기판으로, 유전체를 일정 두께로 가공한 판재 위에 동박 패턴을 이용하여 회로를 형성한다. 일반적인 PCB는 페놀, 에폭시 등 기계적 강도가 높은 재질로 만들어져 휘어지지 않지만, FPCB는 구부림이 가능한 폴리이미드(Polyimide, PI) 필름을 사용해 굴곡을 필요로 하는 제품에 적용되고 있다.

[표 6] 동사의 FPCB용 제품

제품	개요
2 Layer FCCL 	FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)은 Smart Device, 노트북, 안테나, 배터리 등에 사용되는 FPCB의 원판 필름 제품. FCCL의 종류는 동박과 폴리이미드 수지를 접착시키는 접착제 종류에 따라서 2-Layer 또는 3-Layer FCCL로 구분됨. 용도 : 박막, 굴곡성이 요구되는 회로기판용 재료(회로 형성) 특징 : 우수한 굴곡성 및 식각성, 미세회로 에칭 가능, 우수한 내화학성
Black Coverlay 	Black Coverlay는 일반 Coverlay에 비해 Black PI 또는 Black 접착제를 사용하여 회로구성의 육안 차단용 또는 외관상의 Design 다양화가 필요한 부분에 적용. 용도 : 회로 보호 및 휴대폰 케이스 색상 matching용 특징 : 내열 접착성, 전기절연성 우수
Coverlay 	Coverlay는 폴리이미드 필름에 열경화성 에폭시 접착제가 코팅된 복합필름. 용도 : 회로가 형성된 동박적층필름(CCL)의 노출면을 보호, 절연 역할 특징 : 내열 접착성, 전기절연성, 난연성, 내굴곡성, 충진성 우수

*출처: 이녹스첨단소재

FPCB는 동박, FCCL, Coverlay, Bonding Sheet, 보강판 등의 원자재를 적층 가공하는 형태로 제작한다. 동박은 회로 배선용 전도체 역할을 하는 구리를 판재 형태로 가공한 것으로 FCCL에 적층되어 사용하며, FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)은 폴리이미드 필름을 지지층으로 삼아 동박을 한쪽 혹은 양쪽 면에 붙여놓은 판재이다. Coverlay는 FPCB의 동박면을 보호하기 위해 덮는 필름으로, 납땜 시 땜납이 다른 부위에 묻지 않도록 하는 솔더레지스트 역할도 수행하고, Bonding Sheet는 여러 층의 FCCL 적층 시 고정을 위한 접착 필름이다. 그리고 보강판(Stiffener)은 Cover Lay와 Bonding Sheet의 특징을 모두 가진 제품으로

FPCB에 견고함을 부여하기 위해 사용된다.

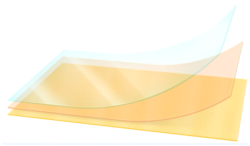
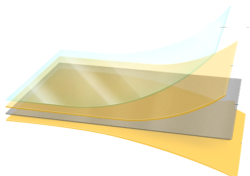
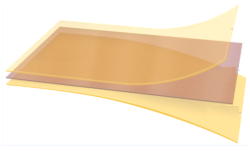
[표 7] 동사의 FPCB 소재 개발 현황

연구과제	연구개발 결과 및 기대 효과
고속전송용 40um피치급 FPCB소재 및 공정기술개발 (2011.05 - 2014. 02)	미세 피치에 따른 전자파 간섭 차단 소재 개발
Rigid-Flex PCB용 고탄성 접착필름 ; Prepreg를 대체할 수 있는 고탄성의 접착필름 개발 (2009. 11 - 2011. 10)	일본으로부터 전량 수입되고 있는 고탄성 접착필름을 국산화시킴으로써 가격경쟁력을 확보

*출처: 이녹스첨단소재

반도체회로는 외부환경으로부터 보호되어야 하고, 전자기기의 구성품으로서 필요한 위치에 연결되어야 한다. 이를 위해 반도체 칩을 보호하고 탑재될 기기에 적합한 형태로 만드는 공정이 필요하며, 이를 패키지 공정이라고 한다. 동사는 반도체 패키징 소재 분야에서 국내에서 유일하게 Full Line-Up을 갖추고 여러 가지 점착 접착 소재를 자체 개발하여 INNOSEM 브랜드로 공급하고 있다.

[표 8] 동사의 반도체 패키지용 제품

제품	개요
QFN Tape 	QFN(Back Side Film) Tape는 반도체 패키지 내의 리드프레임 뒷면에 부착되어 EMC Molding Leakage를 방지해 주는 Tape. 용도 : 리드프레임의 뒷면에 부착 Mold의 Leakage 방지 특징 : 고내열성이며, 테이프를 떼어도 잔류 점착제가 남지 않음. EMC 몰딩 과정에서 Flash Burr가 없고, 고온에서도 리드프레임의 뒤틀림이 적으며, 와이어와 점착력이 우수.
Spacer Tape 	Spacer Tape는 Stack PKG에서 Die to Die 부착용으로 사용되는 열경화성 양면/단면 점착테이프. 동사 모델 INNOSEM HI-(P)ST Series는 폴리이미드 필름에 에폭시계 점착제를 코팅한 후 이형필름으로 보호되어 있음. 용도 : Die간 적층시 사용되는 열경화성 양면/단면 점착테이프 QDP, MCP(Multichip Package), Stack Package에 적용 특징 : 탁월한 작업성, 낮은 ion impurity, 상온에서 Tack 없음, Molding 공정 이후 Void가 완벽히 없어짐.
LOC Tape 	LOC(Lead On Chip) Tape는 메모리반도체 패키지 내의 리드프레임과 칩을 접착시키는 고내열의 양면접착 Tape. 폴리이미드 필름 양면에 내열성 폴리이미드계의 열가소성 접착층으로 구성. 용도 : DRAM Memory, NAND Flash Memory, Package 특징 : 탁월한 작업성(Burr발생 최소화 설계), 폭넓은 작업온도, 우수한 접착력 및 접착제의 균일한 흐름성, 이온불순물 함량 최소화, 실온 저장 안정성.

*출처: 이녹스첨단소재

[표 9] 동사의 반도체 소재 개발 현황

연구과제	연구개발 결과 및 기대 효과
NAND 다단 적층형 DAF 개발 (2015.01 - 2016. 09)	메모리 고집적화에 따른 접착테이프 개발
TSV 3D IC 적층 패키지용 비전도성필름(NCF)개발 (2013.05 - 2016. 04)	-300mm 웨이퍼용 초박형 다층 수직구조형 chip to wafer bonding, chip to chip bonding용 Non conductive film 및 공정개발 -High throughput chip bonder Test module 개발
실리콘 관통 홀 패키지 공정용 임시본딩 & 디본딩 소재 개발 (2012.08 - 2015.07)	-TSV PKG용 임시본딩 접착제의 물성 및 공정개발 -고속 박리를 구현을 위한 Laser 광분해형, UV 광경화형 고분자 수지 조성물 및 시스템 개발
UV-dicing film; Wafer saw用 acryl based 공정 필름 개발 (2007.03 - 2008.01)	-일본산소재가 독점하고 있어 국산화 목표 -광화학 반응 adhesive에 대한 basic 기술 확보, UV 노광 후 Pick up성이 우수한 재료 개발

*출처: 이녹스첨단소재

Die 접착 공정은 와이어 본딩을 사용하는 전통적인 패키징 공정에서 칩을 패키징 기판 위에 접착하여 배선이 가능하도록 준비하는 단계로서, 다이 뒷면의 접착용 금속을 고온에서 용융하여 접합하는 공정 합금 방식, 납합금을 포함하는 곱게 갈린 파우더 입자인 솔더 페이스트 등 전도성 접착제를 기판에 도포하여 칩이 부착된 이후 오븐에서 가열하여 경화 고정하는 방식, Die 접착 필름을 사용하는 방식 등이 적용되고 있다.

반도체 패키징 기술이 CSP(Chip-Scale Packaging), MCP(Multi-Chip Package), WLP(Wafer Level Package) 등으로 발전함에 따라 Die 접착 필름의 적용이 더욱 늘어날 전망이다.

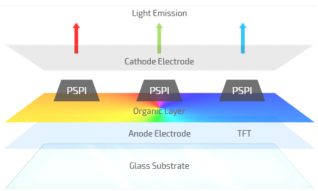
[표 10] 동사의 OLED 소재 개발 현황

연구과제	연구개발 결과 및 기대 효과
Back Plate 개발 (2016.08 - 2018. 07)	- Flexible OLED 패널용 점착소재 기술력 확보 - OLED 패널 공정 평가 이력을 통한 고객 공정 이해도 증대와 신규 물성 항목 발굴 - 품질 이슈 해결 과정을 통해 신규 분석 Tool 확보
OLED TV용 Encap.소재 개발 (2017.01 - 2017. 12)	- OLED TV용 Panel Encap. 소재 Trend에 맞춤 - Tact Time 개선 및 저장 안정성 우수 제품 확보 - 흡습제를 포함한 Formulation Concept
OLED TV용 Encap. 소재 개발 FSPM-17A (2016.01 - 2017.09)	-Olefin Type 적용 신뢰성 3.0um/hr 이하 달성 -고객사 공정개선 및 안정성 확보 -재료 일원화가 가능한 통합 Grade 개발
OLED TV용 Encap.소재개발 FSAM 14A(MA) (2016.05 - 2016.12)	-열경화/UV 경화 Dual Type의 Hybrid Film 개발 -Metal과의 Lamination 및 Laser 타발 기술 확보

*출처: 이녹스첨단소재

OLED 디스플레이는 기존의 LCD 디스플레이와 비교해 밝고 선명한 화면을 구현할 수 있으며, 자체 발광한다는 특징 때문에 경박단소화된 형태의 기기를 만들 수 있고, 플렉시블 디스플레이까지 적용할 수 있는 차세대 디스플레이이다. 동사는 PSPI, 봉지재, Back Plate, Back Plate 보호필름 등 다양한 OLED용 소재를 INNOLED 브랜드로 시장에 공급하고 있다.

[표 11] 동사의 OLED 디스플레이용 제품

제품	개요
Back Plate Film	Back Plate Film은 플렉시블 OLED 디스플레이 패널 Back면에 부착되어 보강판 역할을 하는 점착필름. 용도 : Mobile용 플렉시블 OLED 디스플레이, 웨어러블 디스플레이 특징 : PET Film으로 패널의 Curl 방지 및 제품 보호, 대전처리로 정전기 발생 방지, 내열성 우수한 점착제 적용으로 제품 부착후 점착력 강화
PSPI 	PSPI는 OLED 모듈의 PDL 형성용 감광성 폴리이미드. 용도 : AMOLED용 격벽 소재 특징 : Develope Ability with Alkaline Solution, Low Temperature Cure, Controllable Side Wall Angle, Excellent Thermal Stability, Good Adhesion to Various Substrates

*출처: 이녹스첨단소재

기술 가치를 창조하는 연구개발 중심 기업

동사 연구개발 인력은 123명으로 전체 인원 대비 20% 수준이고, 123명의 연구개발 인력 중 석사 이상 학위보유자는 86명으로 연구개발인력의 70%를 차지한다. 2018년 12월말 기준 특허 59건과 상표권 5건을 포함한 다양한 지식재산권을 보유하고 있고, 제품의 성능 및 품질개선 활동, 신제품 개발을 위한 핵심기술 개발을 수행하고 있다.

사업 초기부터 지식재산권의 중요성을 인지하여 특허등록 등을 통해 당사의 IP를 보호하고 있고, 핵심 특허를 활용하여 관련 시장에서 우위를 점하고 있으며, 지속적인 개량 기술의 특허 출원 및 등록을 통해 기술적인 진입 장벽 구축을 위한 노력을 기울이고 있다. 동사 보유 지식재산권의 효과를 모방하기는 어렵고 실제 매출에 기여하고 있는바, 사업성 측면에서 효과적인 지식재산권에 해당하는 것으로 판단된다. 또한 R&D 과제를 수행하며 향후 실용화를 위한 응용연구를 수행하고 있다.

동사는 시장과 고객의 요구를 반영한 연구개발, 내부 외부자원을 활용한 신규기술 확보, 다양한 기술의 융합과 복합 그리고 기업의 경영전략과 연계 등의 전략을 세우고 연구활동에 임하고 있으며, 이와 같은 전략을 통해 신제품을 적기에 개발하

고, 고객의 만족과 함께 사업성과를 달성하며, 다시 개발역량과 자원활용 극대화를 통한 선순환의 구조를 달성하고 있다.

동사 기술연구소는 첨단소재 개발을 위한 전자 화학 연구개발실외에 디스플레이, 광학, 바이오 등의 다양한 연구개발실을 운영하고 있다. 이와 함께 전문적인 열분석, 물성분석, 표면분석과 전기화학 분석을 하는 연구 분석실을 운영하고 있고, 첨단소재 개발에 필요한 FE-SEM과 GCMS등 300여종의 전문 분석장비 등을 보유하고 있으며, 정부기관 및 대학과의 개발협력 또한 수행하고 있다.

[그림 6] 동사 실험실 분석실



*출처: 이녹스첨단소재

이와 같은 기술개발전략과 시장 Needs 그리고 신소재 융복합기술을 바탕으로 혁신적인 첨단 재료들을 지속적으로 창출하고 있다. 핵심 기술인 고분자 합성 기술과 기능성 수지 기술 그리고 공정기술을 접목하여 다양한 분야의 점착 접착테이프, 코팅 필름, 코팅용 Varnish 및 Paste 등 핵심 Solution 제품을 제공하고 있으며, 이를 바탕으로 신기술 창조를 통해 Global No.1 Advanced Materials Company로 도약하고 있다.

IV. 재무분석

OLED 시장 확대에 따른 지속적인 매출 성장

전방산업인 OLED 시장과 5G 시장 확대에 힘입어 동사의 2019년 3분기 누적 매출은 2,634억원으로 전년 동기 2,164억원 대비 21.7% 증가하였다. 2019년 3분기 기준 수익성 지표를 보면 매출 증가에 따른 영향으로 영업이익률은 전년 대비 12.4%에서 13.4%로 증가하였고, 순이익률 또한 10.5%에서 10.7%로 증가하였다. 그리고 2019년 3분기 부채비율은 해외투자 등에 의한 차입금 증가로 전년 대비 105.3%에서 113.8%로 소폭 증가하였다.

2020년에는 LG디스플레이 광저우공장의 OLED 패널 본격 생산과 애플 신제품 출시 그리고 5G 핸드폰 시장 확대 등의 긍정적인 요인이 있어 동사 매출이 상승할 것으로 기대되고, 수익성 지표 또한 개선될 것으로 예상된다.

[표 12] 주요 재무현황(IFRS 연결 기준)

구분	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년 말	2017년 말
매출액	2,634억원	2,164억원	2,931억원	1,931억원
영업이익	352억원	268억원	382억원	221억원
당기순이익	281억원	227억원	304억원	172억원
영업이익률	13.4%	12.4%	13.0%	11.4%
순이익률	10.7%	10.5%	10.4%	8.9%
부채비율	113.8%	105.3%	105.3%	77.9%

*출처: 분기보고서

업종 평균 대비 성장성과 수익성이 양호

한국은행 기업경영분석자료(2019)에 의하면 최근 3년간 동사가 포함된 [C22. 고무 및 플라스틱 제품] 산업(이하 'C22 산업')의 평균 매출액 증가율은 -0.63%이고, 동사의 3개년 자료는 없으나 최근 매출액 증가율은 51.79%로서 동업종 대비 높은 수준으로 성장성은 양호한 수준이다.

동사의 최근 3년간 평균 영업이익률은 12.28%로서 C22 산업의 평균 영업이익률 5.38% 대비 높은 수준이고, 동업종인 동진쎄미켐(9.89%), S&K폴리텍(5.32%) 대비 높아 수익성은 양호한 수준이다. 그리고 최근 2년간 평균 부채비율은 91.63%로서 동업종인 동진쎄미켐(177.28%), S&K폴리텍(175.50%) 대비 낮아 양호한 수준이나, C22 산업의 평균(72.35%) 대비 안정성 지표는 다소 저조하다.

[표 13] Peer 그룹 분석

구분		2016년	2017년	2018년	평균
이녹스 첨단소재	매출액	-	1,931억원	2,931억원	-
	매출액증가율	-	-	51.79%	51.79%
	영업이익률	-	11.48%	13.07%	12.28%
	부채비율	-	77.92%	105.33%	91.63%
동진쎄미켐 (반도체 및 평판디스플레이용 감광액, 박리액, 세정액 등 제조)	매출액	7,649억원	7,851억원	8,272억원	-
	매출액증가율	7.85%	2.64%	5.36%	5.28%
	영업이익률	5.94%	9.16%	8.58%	7.89%
	부채비율	233.93%	149.32%	148.60%	177.28%
S&K폴리텍 (휴대폰 및 OLED용 Gasket 제조)	매출액	634억원	1,785억원	2,821억원	-
	매출액증가율	147.93%	181.55%	57.99%	129.16%
	영업이익률	5.66%	5.50%	4.79%	5.32%
	부채비율	137.68%	219.60%	169.23%	175.50%
고무 및 플라스틱 제품 (C22) 업종평균 (대기업)	매출액증가율	-1.34%	-0.04%	-0.51%	-0.63%
	영업이익률	7.32%	4.42%	4.41%	5.38%
	부채비율	71.71%	72.29%	73.05%	72.35%

*출처: 네이버 금융, 한국은행, 한국기업데이터 재구성

증권사 투자의견

: BUY

[표 14] 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
하나금융그룹	BUY	73,000원	2019.10.29
	투자의견 BUY, 목표주가 73,000원을 유지. OLED 소재업체들의 PER Range(30배이상) 및 2020년 예상 매출 대비 OLED 소재 비중 51%를 감안하면, 2020년 실적 기준 PER 12배인 현주가 수준은 지나친 저평가 상태라고 판단. 향후 실적 성장 및 전방시장 확대과정에서 Valuation 매력 지속 부각될 것으로 판단. - OLED 소재부문 일본경쟁사 대비 우위. - 업체들 평균 PER 대비 저평가. - 소재 업체들 평균 PER 대비 저평가.		

V. 주요 이슈 및 전망

OLED와 5G 시장 확대가 호재로 작용

OLED 시장은 대형 TV와 핸드폰 시장이 견인하고 있으며, OLED TV와 5G 핸드폰 그리고 OLED 디스플레이 시장 확대는 동사 매출 증가에 크게 기여할 것으로 예상된다. 대형 TV 시장인 경우 LG디스플레이 중국 광저우 8.5세대 OLED 공장이 가동을 시작하면서 2020년부터 본격적인 OLED 시대가 열릴 것이라는 전망이 나오고 있다.

동사 OLED용 소재 매출 비중은 2017년말 22.1%에서 2018년말 33.2%로 증가하였고, 2019 3Q는 더욱 증가하여 38.8%를 점유하며 동사 성장을 견인하고 있다. 특히 동사는 LG디스플레이의 광저우 공장 인근에 2018년 7월 GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.를 신규 설립하며 OLED TV의 시장 성장에 대비하였고, 대형 TV 시장이 OLED로 본격 전환하는 2020년 이후에는 동사의 OLED용 소재가 매출의 주를 이룰 것으로 예상된다.

[표 15] 품목별 매출액과 비중

품목	2019 3Q		2018		2017	
	매출액 (백만원)	비중	매출액 (백만원)	비중	매출액 (백만원)	비중
FPCB용 소재	137,961	52.4%	156,853	53.5%	125.098	64.8%
반도체 패키지용 소재	23,359	8.9%	38,986	13.3%	25.237	13.1%
OLED용 소재	102,147	38.8%	97,276	33.2%	42.769	22.1%
합계	263,467	100%	293,115	100%	193.104	100%

*출처: 이녹스첨단소재, 한국기업데이터 재구성

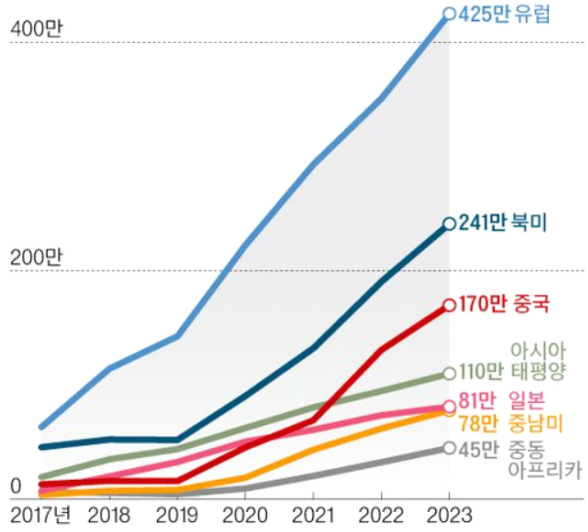
OLED TV 패널은 LG디스플레이만이 공급하고 있으며, LG디스플레이의 OLED 패널 생산량이 증가하는 추세여서 TV 가격이 하락할 것으로 예상되고 있다. LG디스플레이의 광저우 8.5세대 공장에서는 한 장의 유리 원판에서 48인치와 77인치 패널을 동시에 생산하는 등, 파주 생산라인을 포함해 전체 OLED 라인업은 기존의 55 · 65 · 88인치에서 48 · 55 · 65 · 77 · 88인치 등으로 다양해지고 있다

OLED TV 시장은 그동안 패널 공급 부족과 그로 인한 비싼 가격 탓에 진입 장벽이 높았지만, 패널 공급이 늘어나면서 OLED TV 시장도 2019년 4분기부터 크게 증가할 것으로 예상된다. 중앙일보가 인용한 IHS마켓 자료에 따르면 세계 OLED TV 판매량은 2019년 300만대에서 2020년 500만대, 2023년엔 1000만대를 넘어

설 것이란 전망이다.

2020년에 출시될 아이폰 신모델에는 5.4인치, 6.1인치, 6.7인치 등 3종의 OLED가 탑재될 계획이다. 삼성디스플레이는 내년 아이폰용 OLED 3종 가운데 5.4인치와 6.7인치를 단독 납품하는 것으로 예상되고 6.1인치인 경우 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 공급할 것으로 예상되고 있다.

[그림 7] OLED TV 판매 추이 및 전망(단위:대)



*출처: 중앙일보

동사는 LG디스플레이와 삼성디스플레이를 모두 고객사로 두고 있고, 아이폰 신모델에도 OLED용 필름이 적용될 것으로 기대되고 있어 2020년 실적은 한 단계 높아질 것으로 기대되고 있다.

또한 아산공장의 FPCB와 스마트폰 소재 생산라인을 삼성전자 스마트폰 생산기지가 있는 베트남으로 2020년까지 이전하여 FPCB 소재 사업을 강화하고 있는 등, OLED TV와 5G 핸드폰 시장이 성장함에 따라 OLED 소재와 FPCB 소재 매출은 지속적으로 증가가 예상된다.

동사는 IT 소재 회사를 넘어 향후 종합 소재 회사로 변신하려는 계획이 있다. 헤드램프, 리어램프 등 차량용 소재를 발굴하여 2020년 신사업 매출비중을 5%까지 확대하는 등, IT 시장 이외에 자동차 등으로 사업 범위를 확대하고 있다.

동사는 독자적인 기술력을 바탕으로 반도체 패키지 소재, FPCB 소재 그리고 OLED 소재 분야에서 국내 최고의 IT 소재 기업으로 성장하였으며, 지속적인 기술개발과 차세대 성장동력 확보를 통해 세계 No.1의 소재전문 기업으로 도약할 것으로 기대된다.

[표 16] 2020년 아이폰용 OLED 종류와 공급사 예상

구분	특징	공급사
6.7인치	플렉시블 OLED, 터치 일체형	삼성디스플레이
6.1인치	플렉시블 OLED, 필름터치	삼성디스플레이 LG디스플레이
5.4인치	플렉시블 OLED, 터치 일체형	삼성디스플레이

*출처: 전자신문

VI. 별첨

· 기업개요

기 업 명	(주)이녹스첨단소재	대 표 자	장경호 외 1
본 사 주 소	(31409) 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 (석곡리)		
전 화 번 호	041-536-9999	팩 스 번 호	041-531-2772
개업/설립일자	2017년 06월 01일	홈 페 이 지	www.innoxamc.com
사 업 자 번 호	501-86-00680	법인(주민)번호	164811-0105010
기 업 규 모	중기업	기 업 형 태	코스닥시장
업 종 분 류	(C22212) 플라스틱 필름 제조업		
	제조업 > 고무 및 플라스틱제품 제조업 > 플라스틱제품 제조업		

경 영 규 모 (단위: 백만원)	결산일	총자산	납입자본급	자기자본	매출액	순이익
	2018.12.31	298,925	4,485	146,201	292,520	30,715

사업부문	주요제품(상품)	매출구성비
소재 제조 및 판매	FPCB, 반도체, 디스플레이용 소재	100%

· 주요 관계 기업

(단위:백만원)

기업명	결산일	총자산	매출액	당기순이익	관계내용
㈜이녹스	2018.12.31	171,947	8,896	-27,808	(주)이녹스가 동사의 지분을 24.9% 소유
㈜알톤스포츠	2018.12.31	48,302	46,502	-1,516	계열회사
INNOX HONGKONG Co., Ltd.					동사가 INNOX HONGKONG Co., Ltd.의 지분을 100% 소유
GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd					동사가 GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd의 지분을 100% 소유

· 대표자 장경호 주요경력

- 1958년생
- 1993년 KAIST 신소재공학과 공학박사
- 2010년 제47회 무역의날 지식경제부장관상 수상
- 2014년 제8회 EY 최우수기업가상 수상
- 2017.02~현재 : 벤처기업협회 부회장
- 2017.06~현재 : ㈜이녹스첨단소재 대표이사

· 주요연혁

2001-11	반도체 팩키지용 재료 제조판매업 등을 목적으로 각자대표이사 장철규, 장경호에 의해 경기도 안성시 동항리 820-6 소재에서 (주)새한마이크로닉스 설립(납입자본금 1,200백만원)
2005-04	(주)새한마이크로닉스 상호명을 (주)이녹스로 변경
2017-06	반도체용 팩키지용 재료 제조 목적으로 (주)이녹스의 IT 소재부분을 분할하여 설립
	[본점: 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171, 납입자본금:4,306백만원, 대표이사:장경호,김필영]
	경기 성남시 분당구 판교역로 221,12층(삼평동,투썬월드빌딩) 판교지점 설치
2017-07	코스닥시장 상장
2018-03	자본금을 4,485백만원으로 증자
2018-07	GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. 설립
2018-08	INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd. 설립
2018-12	1억불 수출의 탑 수상
2019-03	자본금을 4,616백만원으로 증자
2019-06	판교지점을 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동) 소재로 이전

· 영업양수도

구분	일자	대상기업명	관계내용
영업양수	2017.06.01	㈜이녹스	㈜이녹스 분할하여 설립

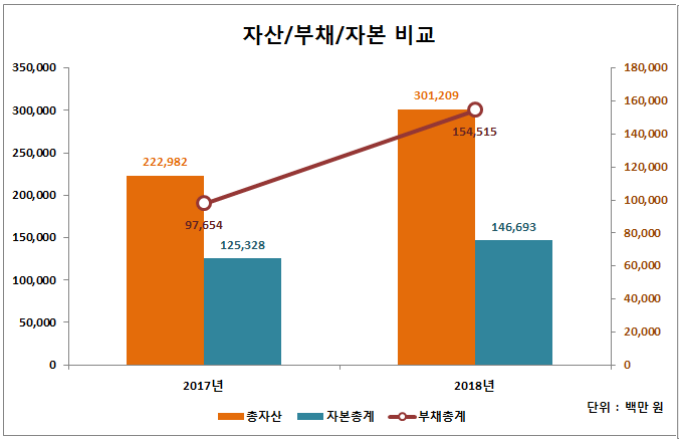
· 주요 지식재산권

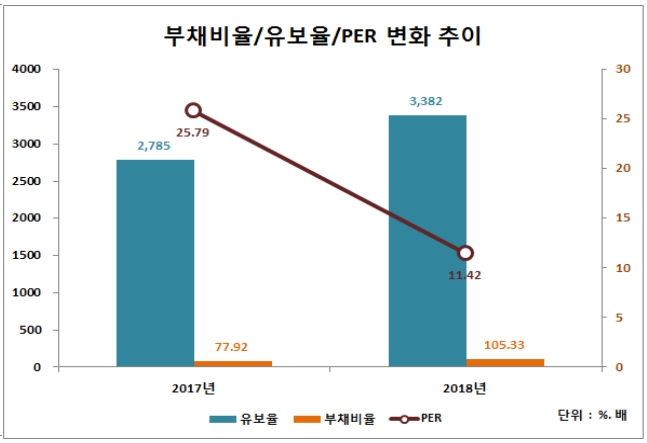
종류	등록번호	등록일자	명칭
특허권	10-1801690	2017.11.21	OLED 패널 하부 보호필름 및 이를 포함하는 OLED 패널
특허권	10-1763605	2017.07.26	유기전자장치용 접착필름 및 이를 포함하는 유기전자장치용 봉지재
특허권	10-1760324	2017.07.17	층간접착력이 우수한 전자파 차폐 및 방열복합시트용 그라파이트 시트, 이를 포함하는 전자파 차폐 및 방열복합시트 및 이의 제조방법
특허권	10-1757229	2017.08.04	전자파 차폐 및 방열 기능 일체형 복합시트 및 이의 제조방법
특허권	10-1753158	2017.07.19	비전도성 접착필름용 조성물 및 이를 포함하는 비전도성 접착필름
특허권	10-1751972	2017.07.19	컨트롤러 다이 매립형 FOD 접착필름 및 이를 포함하는 반도체 패키지
특허권	10-1177774	2012.08.22	회로기판용 접착제 조성물 및 고탄성율의 접착 필름
특허권	10-1089631	2011.11.29	반도체 패키지용 접착필름
특허권	10-1078684	2011.10.26	롤투롤 타입의 금속 베이스 동박적층판의 제조 장치 및 그 제조 방법
특허권	10-0995563	2010.11.15	전자파 차폐용 전기전도성 접착필름
특허권	10-0894173	2009.04.13	반도체 패키지용 접착필름

· 재무상태표

(단위 : 백만 원, K-IFRS연결)

구분	2016년	2017년	2018년
유동자산	-	116,594	161,453
현금 및 현금성자산	-	23,569	76,242
매출채권	-	57,024	42,705
재고자산	-	28,040	35,397
비유동자산	-	106,388	139,756
투자자산	-	-	-
유형자산	-	100,201	133,010
무형자산	-	836	1,470
자산총계	-	222,982	301,209
유동부채	-	95,087	79,351
매입채무	-	14,764	16,444
유동차입부채	-	-	-
단기차입금	-	53,044	38,866
사채	-	-	-
유동성장기부채	-	-	-
비유동부채	-	2,567	75,164
장기차입부채	-	-	68,000
사채	-	-	-
장기차입금	-	-	68,000
부채총계	-	97,654	154,515
지배주주지분	-	125,328	146,693
자본금	-	4,330	4,485
비지배주주지분	-	-	-
자본총계	-	125,328	146,693

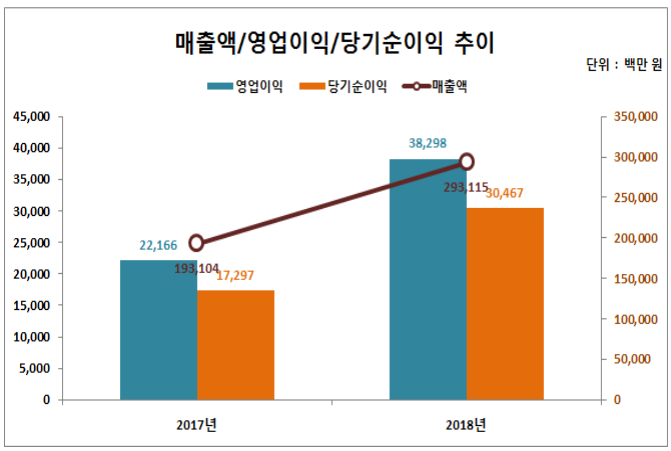


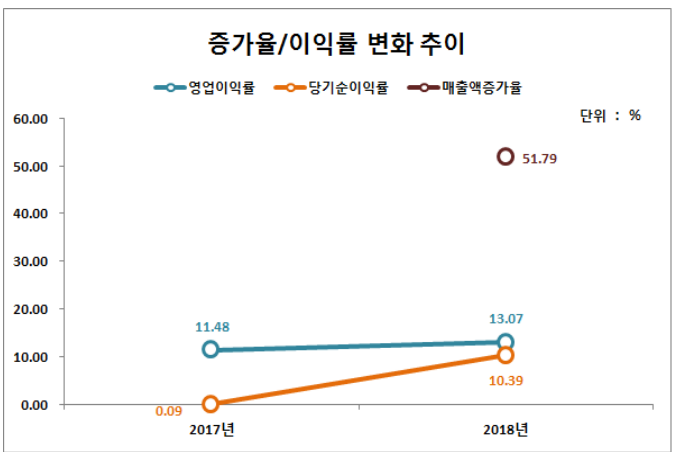


· 손익계산서

(단위 : 백만 원, K-IFRS연결)

구분	2016년	2017년	2018년
매출액	-	193,104	293,115
매출원가	-	139,936	219,263
매출총이익(손실)	-	53,168	73,852
판매비와관리비	-	31,002	35,554
급여	-	3,809	6,916
감가상각비	-	115	219
무형자산상각비	-	59	25
연구 · 경상개발비	-	8,472	13,330
영업이익(손실)	-	22,166	38,298
영업외수익	-	2,178	4,047
영업외비용	-	3,234	4,464
이자비용	-	861	1,771
법인세차감전순손익	-	21,110	37,880
법인세비용	-	3,813	7,413
계속사업이익(손실)	-	17,297	30,467
중단사업이익(손실)	-	-	-
당기순이익(순손실)	-	17,297	30,467
지배회사지분순손익	-	17,297	30,467
소수주주지분순손익	-	-	-





· 현금흐름표

(단위 : 백만 원, K-IFRS연결)

구분	2016년	2017년	2018년
영업활동으로 인한 현금흐름	-	**22,433**	**51,358**
당기순이익(손실)	-	17,297	30,467
현금의 유출이 없는 비용	-	22,704	23,102
퇴직급여	-	1,224	2,066
유형자산 등 상각비	-	5,311	10,096
무형자산 상각비	-	116	271
현금의 유입이 없는 수익	-	377	885
자산부채의 변동	-	- 17,191	- 1,327
매출채권의 감소(증가)	-	- 6,559	11,279
재고자산의 감소(증가)	-	333	- 7,357
매입채무의 증가(감소)	-	- 3,993	1,606
투자활동으로 인한 현금흐름	-	**- 11,576**	**- 43,769**
투자활동 현금유입	-	10	148
유동성금융자산 등 감소	-	-	76
유무형자산의 감소	-	10	72
투자활동 현금유출	-	11,586	43,917
유동성금융자산 등 증가	-	86	2,324
유무형자산의 증가	-	11,500	41,593
재무활동으로 인한 현금흐름	-	**- 18,261**	**45,128**
재무활동 현금유입	-	25,423	124,015
장단기차입금 증가	-	24,201	72,953
사채 증가	-	-	50,000
자본금 증가	-	-	-
재무활동 현금유출	-	43,683	78,887
장단기차입금 감소	-	43,428	69,139
사채 감소	-	-	-
자본조정의 감소	-	255	9,670
유동성장기차입금의 감소	-	-	-
현금의 증가(감소)	-	**- 7,540**	**52,674**
기초현금	-	31,109	23,569
기말현금	-	23,569	76,242

